

請求の範囲

- [請求項1] 炭素数 6 ～ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 6 ～ 12 の脂肪族炭化水素オキシ基を有するヒドロキシベンゾフェノン化合物を含む、硬化性樹脂組成物用添加剤。
- [請求項2] 前記ヒドロキシベンゾフェノン化合物が有するヒドロキシ基の数が 1 又は 2 である、請求項 1 に記載の硬化性樹脂組成物用添加剤。
- [請求項3] 前記ヒドロキシベンゾフェノン化合物が有する炭素数 6 ～ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 6 ～ 12 の脂肪族炭化水素オキシ基の数が 1 又は 2 である、請求項 1 又は請求項 2 に記載の硬化性樹脂組成物用添加剤。
- [請求項4] 請求項 1 ～請求項 3 のいずれか 1 項に記載の硬化性樹脂組成物用添加剤と、硬化性樹脂成分とを含む、硬化性樹脂組成物。
- [請求項5] 前記硬化性樹脂成分がエポキシ樹脂と硬化剤とを含む、請求項 4 に記載の硬化性樹脂組成物。
- [請求項6] 電子部品装置の封止材として用いるための、請求項 4 又は請求項 5 に記載の硬化性樹脂組成物。
- [請求項7] 素子と、前記素子を封止する請求項 4 ～請求項 6 のいずれか 1 項に記載の硬化性樹脂組成物の硬化物と、を備える電子部品装置。